

50 μ m 高純度タングステン箔



実物大

純度	99.9999% (6N 相当)
製造可能寸法	70 × 54 × 0.05 (mm) (半導体分野で使われる W 材料を弊社独自技術で加工)
厚さのばらつき	t48 ~ t52 (μ m) (t50 ± 5% 以内)
表面粗さ	Ra0.3 (μ m)
製作可能寸法	100 × 100 (mm) 程度 (極薄板の場合)
製作可能厚さ	t40 μ m 程度まで加工可能 (厚さのばらつきが拡大傾向)
表面状態	梨地状の表面にすることも可能 (表面積拡大等)
納期 / 販売価格	要相談

問い合わせ先 : 金属技研株式会社 営業本部

担当: 大木

TEL : 03-5365-3035

E-mail : info@kinzoku.co.jp

URL : <http://www.kinzoku.co.jp>